

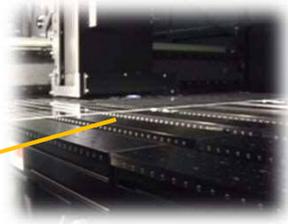
ひとわざ(一技)名: 中小型ディスプレイ向けカバーガラスのレーザー切断・外形加工

1. 概要(200字目安)

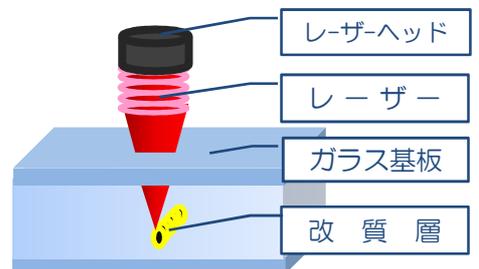
- ◆高DOL・高CT化学強化ガラスの切断加工
レーザー加工工法により高い化学強化ガラスを加工する事が可能
DOL>40μm CT>45Mpa
- ◆G6基板ガラス大判からのシート加工
大判のガラス基板にセンサー、加飾パターンが形成された基板をそのまま切り出し
個片化する事が可能
対応原版サイズ: 第2世代(370mm×470mm)～第6世代(1500mm×1850mm)

写真・図(要点説明)

レーザー切断



マイクロドリリング (非熱レーザー加工)



レーザーヘッド
レーザー
ガラス基板
改質層

非熱加工 フェムト秒レーザーを用いて、ガラス基板の内部に集光させて改質層を作り出す事により熱影響の発生無く加工が出来る。

ポリッシング



BEFORE



AFTER



端面の面取り研磨(鏡面研磨) レーザー切断加工後の端面を鏡面に仕上げる事で チッピング(マイクロクラック)除去する事により、高い曲げ強度を達成出来る。

2. 企業概況

会社名	株式会社 ニチワ工業		代表者名	寺澤 茂
			窓口担当	小平 晃
事業内容			URL	http://www.nichiwak.co.jp
主要製品	精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造、工場野菜の販売等			
住所	〒391-0003 長野県茅野市本町東3-17			
電話/FAX	0266-82-6025		E-mail	info2@nichiwak.co.jp
資本金(百万円)	15	設立年月日	1970年3月1日	売上(百万円) ー 従業員数 120

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

②異形状加工・穴あけ加工・C面取加工も対応可能 4インチ～20インチ相当まで